

#### Electronics for the Future

# 決算発表 補足資料 2024年度 第2四半期業績

2024年11月8日 ローム株式会社 広報IR部

# 2024年度 第2四半期 実績 業績報告(前年同期比)



(単位:億円)

	FY2024 第2四半期 実績	FY2023 第2四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,137	1,191	<b>▲54</b>	<b>▲4.5</b> %
営業利益	▲22	121	<b>▲143</b>	-
(対売上比率)	( ▲2.0%)	( 10.2%)	-	-
経常利益	<b>▲</b> 93	220	▲314	-
(対売上比率)	( ▲8.2%)	( 18.5%)	=	-
純利益	<b>▲</b> 13	171	<b>▲185</b>	-
(対売上比率)	( ▲1.2%)	( 14.4%)	-	-
EBITDA	183	286	▲103	<b>▲</b> 36.1%
(対売上比率)	( 16.1%)	( 24.0%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$)

(150.26円)

(145.44円)

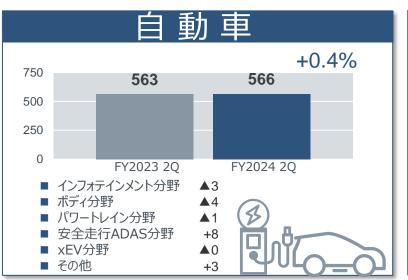
期末レート(¥/US\$) (142.73円)

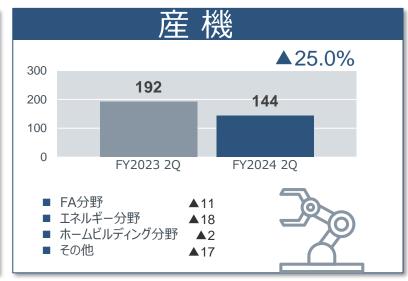
(149.58円)

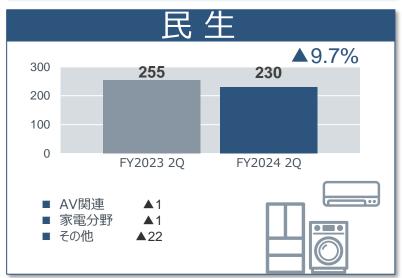
#### 2024年度 第2四半期 市場別 売上の変動要因 (前年同期比)

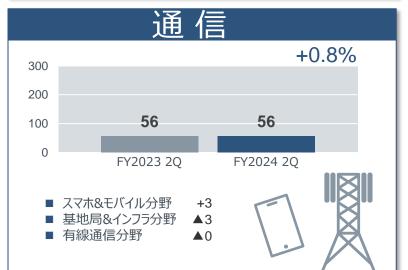


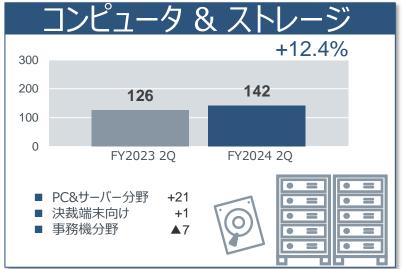






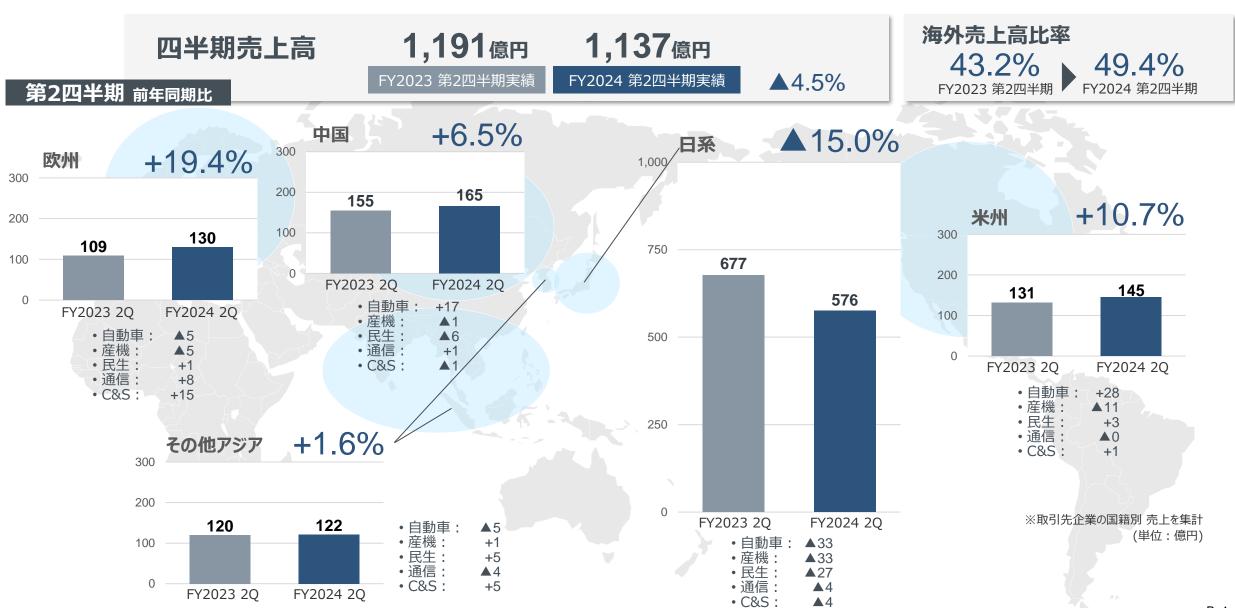






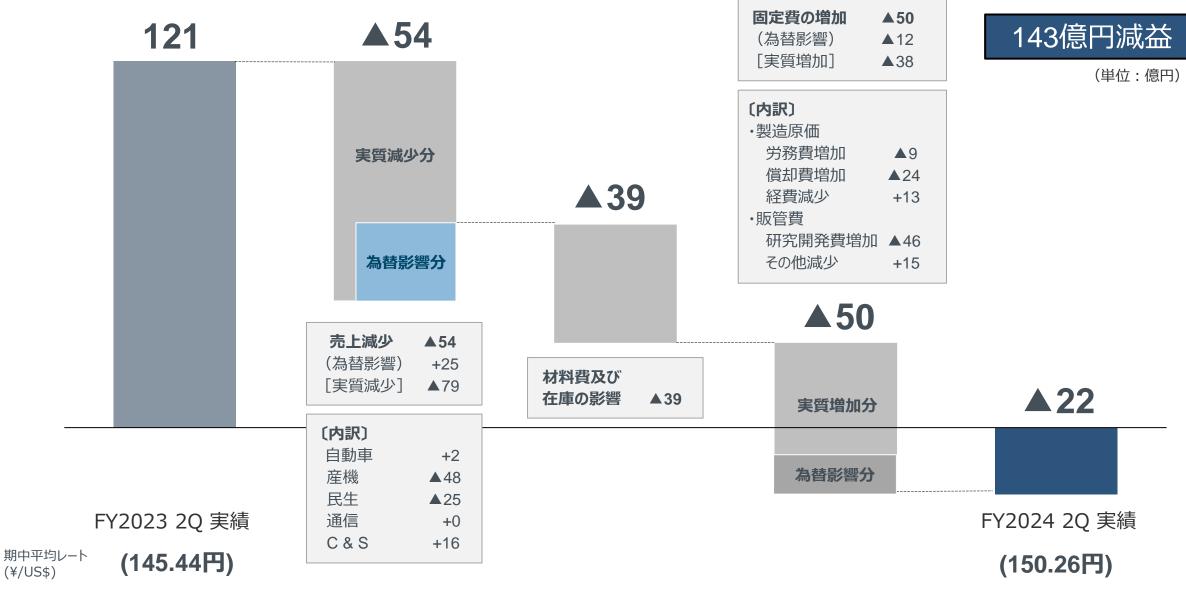
#### 2024年度 第2四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)





## 2024年度 第2四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)





# 2024年度 第2四半期 セグメント別 (前年同期比)



		FY2024 第2四半期 実績	FY2023 第2四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	504	532	▲27	<b>▲</b> 5.1%
	セグメント利益	15	44	▲29	<b>▲</b> 65.7%
	(利益率)	( 3.0%)	( 8.4%)	-	-
半導体素子	売上	483	504	▲21	<b>▲4.3</b> %
	セグメント利益	<b>▲</b> 54	52	▲107	-
	(利益率)	( ▲11.3%)	( 10.4%)	-	-
モジュール	売上	87	88	▲0	▲0.5%
	セグメント利益	13	14	▲1	<b>▲7.7</b> %
	(利益率)	( 15.5%)	( 16.7%)	-	-
その他	売上	61	66	<b>4</b>	<b>▲4.5</b> %
	セグメント利益	8	6	+1	+20.3%
	(利益率)	( 13.4%)	( 10.4%)	-	-

# 2024年度 第2四半期 実績 業績報告(直前四半期比)



(単位:億円)

	FY2024 第2四半期 実績	FY2024 第1四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,137	1,182	<b>▲45</b>	<b>▲3.8</b> %
営業利益	▲22	12	▲35	-
(対売上比率)	( ▲2.0%)	( 1.1%)	-	-
経常利益	<b>▲93</b>	92	▲186	-
(対売上比率)	( ▲8.2%)	( 7.8%)	-	-
純利益	<b>▲</b> 13	34	<b>▲</b> 48	-
(対売上比率)	( ▲1.2%)	( 2.9%)	-	-
EBITDA	183	210	▲27	<b>▲13.0</b> %
(対売上比率)	( 16.1%)	( 17.8%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$)

(150.26円)

(156.53円)

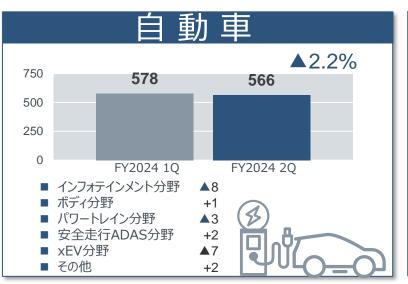
期末レート(¥/US\$) (142.73円)

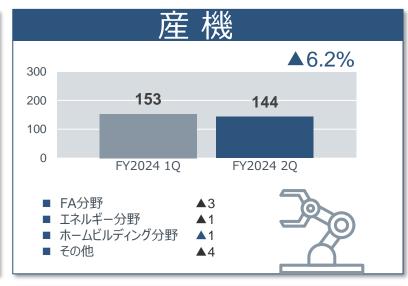
(161.07円)

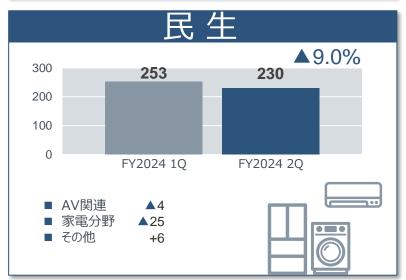
#### 2024年度 第2四半期 市場別 売上の変動要因 (直前四半期比)

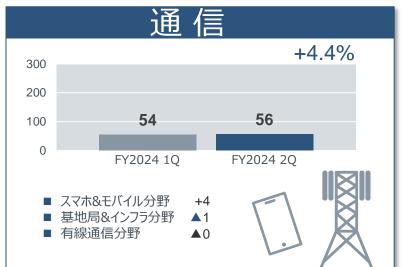


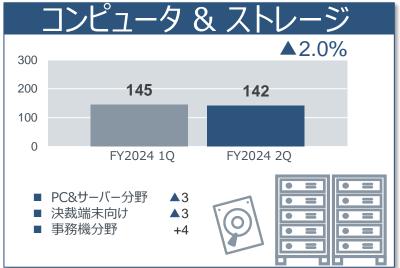






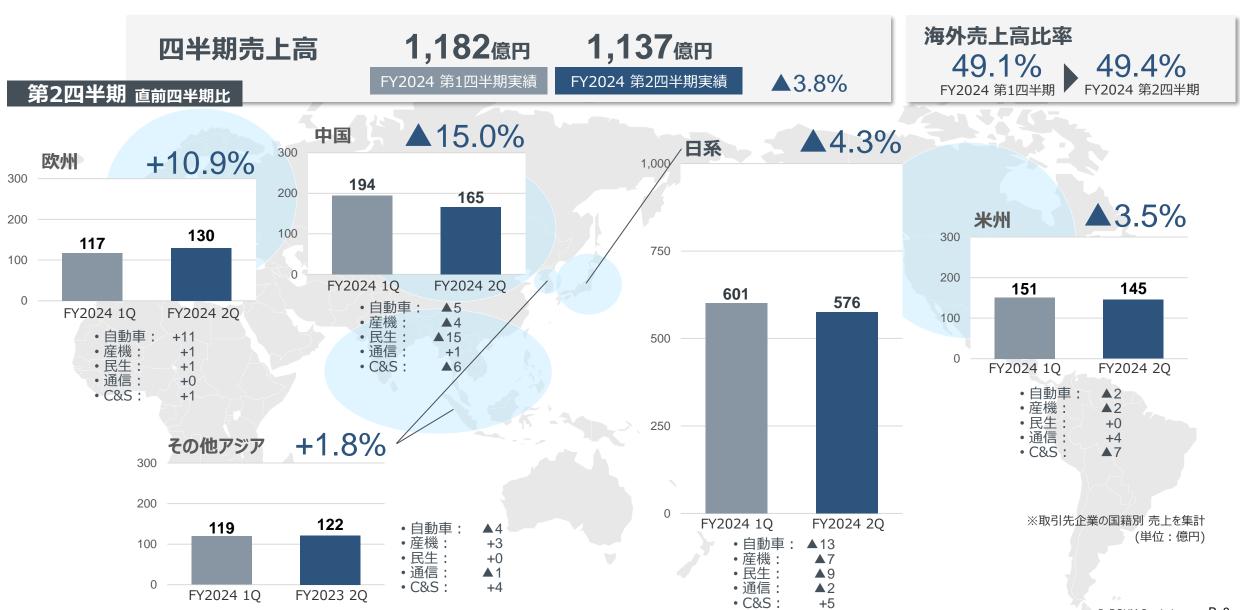






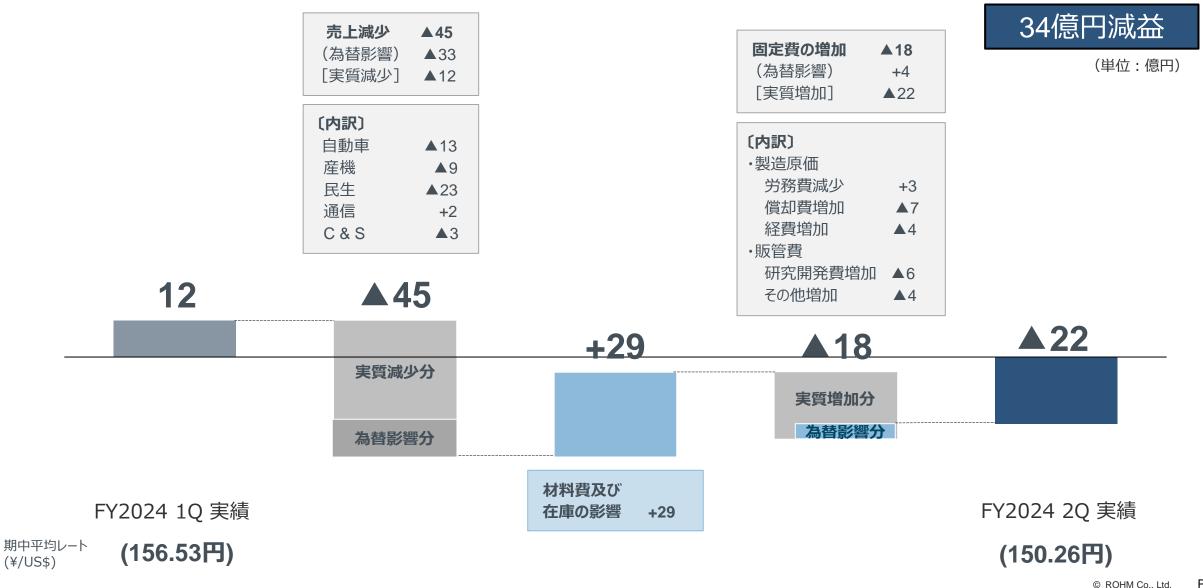
## 2024年度 第2四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)





# 2024年度 第2四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)





# 2024年度 第2四半期 セグメント別 (直前四半期比)



		FY2024 第2四半期 実績	FY2024 第1四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	504	537	▲32	<b>▲6.1%</b>
	セグメント利益	15	40	▲24	<b>▲61.8%</b>
	(利益率)	( 3.0%)	( 7.4%)	-	-
半導体素子	売上	483	489	<b>A</b> 6	<b>▲1.3</b> %
	セグメント利益	<b>▲</b> 54	<b>▲</b> 49	<b>▲</b> 5	-
	(利益率)	( ▲11.3%)	( ▲10.1%)	-	-
モジュール	売上	87	89	▲1	<b>▲1.5</b> %
	セグメント利益	13	7	+5	+73.4%
	(利益率)	( 15.5%)	( 8.8%)	-	-
その他	売上	61	66	<b>4</b>	<b>▲7.2</b> %
	セグメント利益	8	7	+1	+17.9%
	(利益率)	( 13.4%)	( 10.6%)	-	-

#### 2024年8月~2024年11月のNews Release一覧



- 2024-08-21 産機電源に最適なSOPパッケージ汎用AC-DCコントローラIC4種を発売
- 2024-09-05 UAES社とローム、SiCパワーデバイスの長期供給契約を締結
- 2024-09-25 1kW級の高出力赤外レーザーダイオード「RLD8BQAB3」を開発!
- 2024-09-27 芯動半導体とローム、戦略的パートナーシップ契約を締結
- 2024-09-30 デンソーとローム、半導体分野において戦略的パートナーシップの検討開始に合意
- <u>2024-09-30</u> 体積を従来方式の1000分の1以下に小型化!業界最小\*のテラヘルツ波 発振デバイス・検出デバイス のサンプル提供を開始
- 2024-10-01 ESG説明会を開催
- 2024-10-01 社内炭素価格 (インターナルカーボンプライシング) 制度を導入
- 2024-10-23 □-ムのEcoSiC™がコーセル株式会社の3.5kW出力AC-DC電源ユニット「HFA/HCAシリーズ」に採用
- 2024-10-31 ローム独自のHDモノラルモードを搭載!ハイレゾ音源再生に適したMUS-IC™シリーズのオーディオDAC チップ第2世代品を開発
- 2024-11-07 車載電動コンプレッサや産業機器インバータ等の高効率化に貢献業界トップクラス<sup>※</sup>の低損失特性・高短 絡耐量を実現した1200V IGBTを開発



# Electronics for the Future